

Компактный автоматизированный кластер нанесения и проявления фоторезиста



Цена:

Цена по запросу

Описание

- 1. Возможность использования широкой линейки фоторезистов и проявителей, наличие до 12 горячих/холодных плиток.
- 2. Максимальная функциональность при небольшой площади в чистом помещении (\sim 1.7 м²) для задач мелко-серийных производств и научно-исследовательских лабораторий;
- 3. Можно одновременно использовать 2 размера пластин без переналадки установки;
- 4. Обладает полным набором функций, включая ГМДС (HMDS), удаление краевого валика (EBR), отмывку обратной стороны (BSR), RRC, защиту сопла от засыхания, а также автоматическую очистку;
- 5. Может быть оснащено удобным сменным соплом подачи фоторезиста игольчатого типа;
- 6. Опционально доступен контроль температуры проявителя фоторезиста.
- 7. Модульная конструкция падаптируемая под задачи заказчика

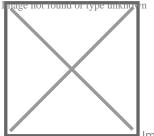


Image not found or type unknown

Пример конфигурации установки

Конфигурация:	1C1D 2C2D
Материал пластин	Si, сапфир, GaAs, InP, GaN, SiC, LT, LN и др.
Размер пластин	50 – 150 мм (опция 200/300 мм)

Размер топологии	≥0,35 мкм (опция ≥90 нм)
Применимый процесс	G-line, i-line, PI (полиимид) Опция KrF, ArF, SOG, SOC
Область применения	МЭМС, силовые приборы, радиочастотные технологии, оптоэлектроника, светодиоды, научные исследования и др.
Размеры:	1180*1450*2040 мм (Ш*Г*В)